

第1回 集積化 MEMS 技術研究ワークショップ
 (第57回東京工業大学精密工学研究所シンポジウム)

2009年7月14日 東工大すずかけホール3F

時間	すずかけホール 多目的ホール	ラウンジ	見学
10:00 ~ 10:05	開会の辞 (豊橋技術科学大学 石田 誠)		
10:05 ~ 10:25	一般講演 「MEMS 技術とコンビナトリアル技術の融合」 (東京工業大学 秦 誠一)		
10:25 ~ 10:45	一般講演 「MEMSpice による MEMS-制御電子回路の連成解析」 (数理システム 望月俊輔)		
10:45 ~ 11:05	一般講演 「マイクロ流体技術による乳化操作と微粒子設計」 (東京工業大学 西迫貴志)		
11:05 ~ 11:45	招待講演 「最近の RF MEMS デバイスの開発動向」 (富士通研究所 上田知史)		
11:45 ~ 13:00	昼休	ポスター準備	
13:00 ~ 13:40	基調講演 「集積強誘電体技術の現状 - 強誘電体膜の不揮発メモリ、センサ、アクチュエータ応用」 (東京工業大学 石原 宏)		
13:40 ~ 14:00	一般講演 「サブミクロン Au 粒子を用いた気密封止パッケージング向けウエーハ接合技術」 (ズース・マイクロテック(株) 石田 博之)		
14:00 ~ 14:30	特別講演 「MEMS 共振器を用いた面発光レーザの波長制御」 (東京工業大学 小山二三夫)		
14:30 ~ 14:50	一般講演 「電気回路シミュレータ Qucs を用いた MEMS アクチュエータの連成解析手法」 (東京大学 丸山智史)		
14:50 ~ 15:00	休憩		
15:00 ~ 16:00			
16:00 ~ 16:30	特別講演 「薄化ウエハ基盤を用いた三次元積層技術」 東京大学 大場隆之	ポスターセッション	実験室見学
16:30 ~ 17:30			
17:30 ~ 19:00		懇親会	